



Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon M580
Produkt- oder Komponententyp	Redundante Prozessormodule
Imprägnierungsmaterial	Schutzbeschichtet

Zusatzmerkmale

Anzahl von Racks	1
Anwendungsspezifischer E/A	Genaue Zeitstempelung HART Zähler SSI-Encoder Serielle Schnittstelle Motion Control
Prüfungen	Prozesssteuerung
Steuerkanäle	Programmierbare Regelkreise
Integrierte Verbindungsart	1 Ethernet TCP/IP für Service-Port 2 Ethernet TCP/IP für Gerätnetzwerk USB Typ Mini-B 1 Ethernet für HSBY-Port
Anzahl entfernter E/A-Stationen	16 - 2 Einbaueinheit pro X80 und Quantumabfall
Anzahl verteilter Geräte	64
Kapazität des Kommunikationsbaustein-Prozessors	8 AS-Interface-Modul 4 Ethernet-Kommunikationsmodul
Kommunikationsdienst	DIO-Scanner RIO-Scanner
Speicherbeschreibung	Erweiterbar Flash, 4 GB für Datenspeicherung Integriert RAM, 10 KB für Systemspeicher Integriert RAM, 16 MB für Programm Integriert RAM, 2.048 kB für Daten
Anwendungsstruktur	1 periodische Fast Task 1 zyklisch/periodische Master Task
Anzahl der Anweisungen pro ms	30 kAnw/ms 65% boolesch + 35% fest-arithmetisch 40 kAnw/ms 100 % boolesch
Stromaufnahme	360 mA bei 24 V DC
MTBF Zuverlässigkeit	650000 H
Beschriftung	CE

Montage

Vibrationsfestigkeit	3 gn
Stoßfestigkeit	30 gn
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Betriebshöhe	0 - 2.000 m 2000 - 5000 m mit Leistungsminderungsfaktor
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 % bei 55 °C ohne Kondensation
Schutzart (IP)	IP20
Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit 2014/34/EU - ATEX-Richtlinie
Produktzertifizierungen	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]Handelsmarine[RETURN] Zone 2/22[RETURN]IECEx Zone 2/22
Normen	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, Interface Typ 1 und Type 2 EN/IEC 61850-3, Standort G EN/IEC 60079-0
Umgebungseigenschaften	Gasbeständig Klasse Gx entspricht ISA S71.04 Gasbeständig Klasse 3C4 entspricht IEC 60721-3-3 Staubbeständig Klasse 3S4 entspricht IEC 60721-3-3 Sandbeständigkeit Klasse 3S4 entspricht IEC 60721-3-3 Salzbeständig Level 2 entspricht IEC 68252 Spritzgussbeständigkeit Klasse 3B2 entspricht IEC 60721-3-3 Pilzsporen-resistent Klasse 3B2 entspricht IEC 60721-3-3 Gefahrenbereich Klasse I Division 2
Beschichtung	Schutzlack
Versorgung	Interne Stromversorgung über Modulträger
LED-Statusanzeige	1 LED (grün) Prozessor in Betrieb (RUN) 1 LED (rot) Prozessor- oder Systemfehler (ERR) 1 LED (rot) I/O Modulfehler (I/O) 1 LED (grün) Downloadvorgang aktiv (DL) 1 LED (rot) Speicherkarten- oder CPU-Flash-Fehler (BACKUP) 1 LED (grün/rot) ETH MS (Konfigurationsstatus Ethernet-Schnittstellen) 1 LED (grün/rot) Eth NS (Ethernet-Netzwerkstatus) 1 LED (grün) Peer-Prozessor in Betrieb (REMOTE RUN) 1 LED (grün) Prozessor-ID Satz bis A (A) 1 LED (grün) Prozessor-ID Satz bis B (B) 1 LED (grün) Prozessor primär (PRIM) 1 LED (grün) Prozessor Standby (STBY) 1 LED (grün) E/A-Werte durch Nutzer überschrieben (FORCED IO) 1 LED (grün) Hot-Standby-Verbindungsstatus (HSBY Diag)
Produktgewicht	0,849 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,700 cm
VPE 1 Breite	18,000 cm
VPE 1 Länge	25,300 cm
VPE 1 Gewicht	889,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,847 kg

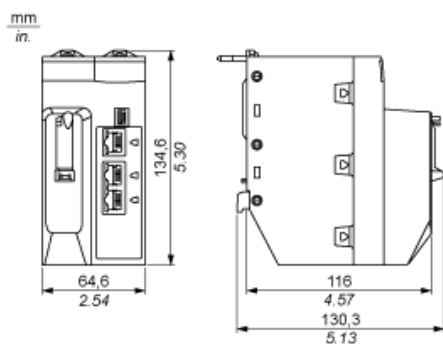
Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

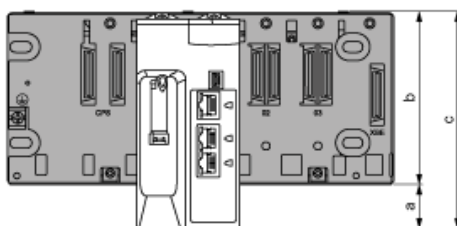
Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nur CPU-Module

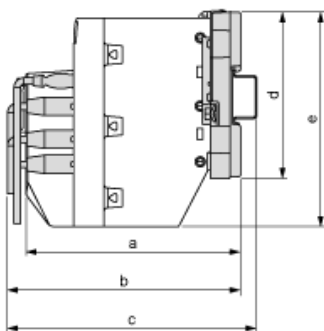


Auf Racks montierte Module



- a: Zusätzlicher Abstand unter dem Rack zur Berücksichtigung der Höhe der CPU. X Bus-Rack: Der Abstand beträgt 30,9 mm (1.217 in.) Ethernet-Rack: Der Abstand beträgt 29,49 mm (1.161 in.)
- b: Die Höhe des Racks. Für ein X Bus-Rack beträgt die Höhe 103,7 mm (4.083 in.); für ein Ethernet-Rack beträgt die Höhe 105,11 mm (4.138 in.).
- c: Die Höhe des lokalen Haupttracks, 134,6 mm (5.299 in.)

In ein Gehäuse montierte Module und Kabel



- a: Gehäusetiefe: 135 mm (5.315 in.)
- b: Tiefe Verdrahtung + Modul: > 146 mm (5.748 in.)
- c: Verdrahtung + Modul + DIN-Schientiefe: > 156 mm (6.142 in.)
- d: Rackhöhe: X Bus-Rack 103,7 mm (4.083 in.); für ein Ethernet-Rack, 105,11 mm (4.138 in.)
- e: Modulhöhe: 134,6 mm (5.299 in.)